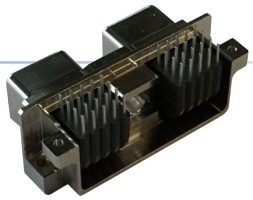
MODULES SIM OPLF

Design du module permettant l'assemblage en automatique sur la carte
Design de contact raccourci pour un gain de place sur la carte



Aéronautique
Défense

MODULES ET CONTACTS

MODULES

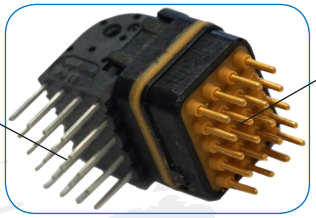
Amphenol Air LB a élargi sa gamme de modules EN4165 en créant le module SIM OPLF, alternative innovante et performante aux modules standards équipés de picots coudés à piquer sur C.I.

Sa technologie consiste en bandes de contacts encapsulées chacune dans un boîtier en composite LCP surmoulé et qui sont ensuite assemblées dans un corps de module SIM OPLF au format EN4165.
Le surmoulage en LCP (Polymères à Cristaux Liquides) :
- Garantit l'**isolement entre contacts**
- Permet un **assemblage en automatique** sur C.I grâce à un ensemble solidaire (contacts fixes) -> **Installation rapide**

Amphenol Air LB peut fournir, sur demande, le conditionnement adéquat pour une intégration en automatique.

Module SIM OPLF démontable du corps du connecteur permettant une **maintenance éventuelle plus facile**.

Module SIM OPLF avec un **encombrement réduit** :
- Autorise une taille réduite de C.I
- Permet un gain de place pour les autres composants

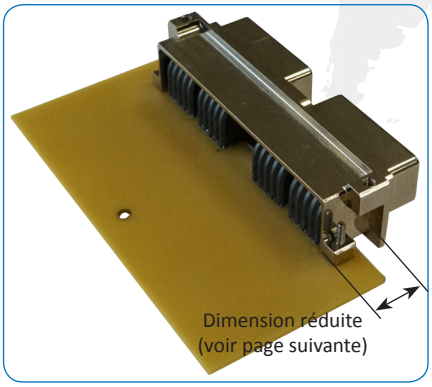


Partie active : dorée 0,76 µm Or sur Nickel
Partie raccordée au C.I : étamée

CONTACTS

Contacts mâles en alliage cuivreux.
Taille de contacts : #22
Partie active compatible avec les contacts femelles EN3155 et SAE39029.

EMBASES RACCOURCIES



Amphenol Air LB a développé des embases spécifiques SIM raccourcies pour les modules SIM OPLF, permettant ainsi d'optimiser l'encombrement global sur le C.I.

QUALIFICATIONS

Ces embases, développées selon la norme EN4165, sont compatibles avec toutes les fiches SIM/EN4165 équipées de modules femelle #22.

Conformité Reach des connecteurs et modules.
Conformité RoHS des embases métalliques / composites nickelées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les caractéristiques techniques des embases raccourcies sont identiques à celles des embases standards SIM/EN4165 (voir le catalogue "Connecteurs SIM").
Les modules OPLF résistent au nettoyant type VIGON dilué à 30%.

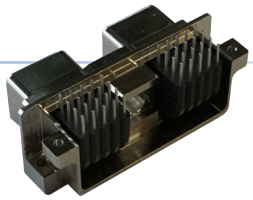
Taille de la carte réduite -> **GAIN DE PLACE**
Poids associé optimisé -> **GAIN DE MASSE** → **RÉDUCTION DE COÛTS**
Automatisation du montage -> **GAIN DE TEMPS**

Amphenol Air LB
Your Satisfaction. Everyday. Everywhere.

Service Clients - 2 rue Clément ADER, Zac de Wé - 08110 Carignan - FRANCE
Tél : +33 (0)3 24 22 32 66 - Fax : +33 (0)3 24 22 38 72 - service-client@amphenol-airlb.fr - www.amphenol-airlb.fr

MODULES SIM OPLF

Design du module permettant l'assemblage en automatique sur la carte
Design de contact raccourci pour un gain de place sur la carte



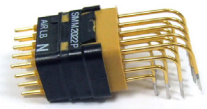
Aéronautique
Défense

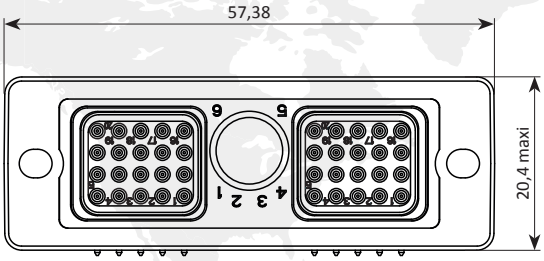
DESSINS TECHNIQUES

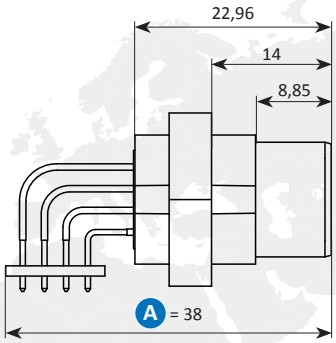
Le design du module SIM OPLF permet d'optimiser le gain de place sur C.I.
La dimension A passe de 38 mm à 26,95 mm -> gain de 11 mm.

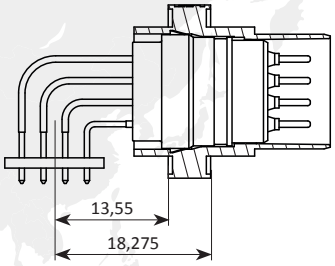
Comparatif dimensionnel entre module standard et module OPLF :

MODULE SIM STANDARD AVEC CONTACTS À PICOTS COUDÉS

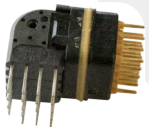


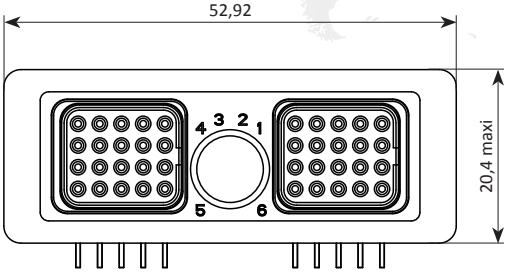


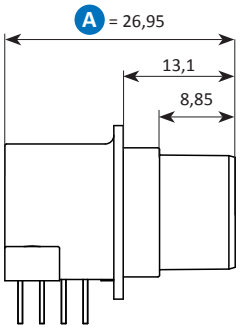


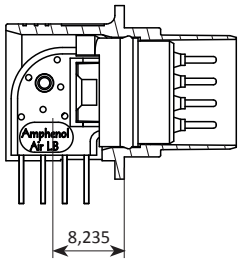


MODULE SIM OPLF









Ce document n'est pas contractuel. Les informations contenues dans ce catalogue sont susceptibles d'évolution.
Amphenol Air LB France se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Pour tout renseignement complémentaire, nous consulter.
Droits d'auteurs : Avions © AIRBUS S.A.S. 2013 – photo by exm company | F. LANCELOT ; Hélicoptère © Anthony PECCHI | AIRBUS Helicopters ; Rail © Aleksandar Mijatovic | Fotolia ; Industrie © Nataliya Hora | Fotolia ; Centrale © Kletr | Fotolia ; Tension © Rumkugel | Fotolia